

Zamawiający:

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Gdańsk, dnia 13.11.2024 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) pn. „Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby projektu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr CRZP/219/009/D/24, ZP/92/WETI/24, ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/S 200-619768.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły poprzez *Platformę zakupową*:

Pytania dotyczące Części 1 postępowania CRZP/219/009/D/24

– Dostawa komputera wysokowydajnego do obliczeń dynamiki molekularnej

Pytanie 1:

W zakresie części 1 – Dostawa komputera wysokowydajnego do obliczeń dynamiki molekularnej czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie pamięci RAM 2 x 32GB DDR5 o zakresie opóźnienia CL 46-48 i zakresie częstotliwości 5600MHz? Pragniemy zwrócić uwagę, że wyspecyfikowane parametry techniczne tzn. CL 32-36 oraz zakres częstotliwości 5600-6000MHz dotyczą pamięci UDIMM (dla Intel), one nie są kompatybilne z chipsetem płyty TRX50. Z chipsetem TRX50 kompatybilne są pamięci RDIMM, a te z kolei występują z maksymalnym taktowaniem 5600 MHz i opóźnieniem typowym dla rozwiązań serwerowych tzn. CL 46-48. Jednocześnie brak zgody uniemożliwi złożenie jakiegokolwiek oferty, gdyż nie będzie takiego rozwiązania na rynku biorąc pod uwagę typ chipsetu i rodzaj procesora.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Zamawiający zmieni Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w Części 1.

Pytanie 2:

W zakresie części 1 Zamawiający wskazał zapis, że wymaga chłodzenia procesora na poziomie NSPR 130, ilość ciepłowodów min. 6, ilość wentylatorów min. 2, żywotność min. 300 000 godzin. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie ma na rynku takiego chłodzenia dla opisywanego procesora. Chłodzenie na poziomie NSPR 130 występuje, ale o żywotności 150 000 godzin, a nie 300 000 godzin. Czy Zamawiający dopuści lepsze chłodzenie niż opisywane tzn. typowo do rozwiązania serwerowego (dla opisywanego procesora), ilość ciepłowodów 8 szt., ilość wentylatorów 2 szt., żywotność 40 000 godzin? W przypadku braku zgody czy Zamawiający zgodzi się na chłodzenie procesora na poziomie NSPR 179, o żywotności min. 150 000 godzin, ilość ciepłowodów 6 szt., ilość wentylatorów 2 szt.? Jednocześnie brak zgody na obydwie propozycje uniemożliwi złożenie jakiegokolwiek ważnej oferty (zgodnej z opisem).

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na chłodzenie procesora na poziomie min. NSPR 130 i żywotności min. 150 000 godzin, ilość ciepłowodów min. 6 szt., ilość wentylatorów 2 szt.

Zamawiający zmieni Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w Części 1.

Pytanie 3:

W części 1 przy opisie płyty głównej Zamawiający wskazał zapis, że wymaga złącze SYS FAN 4-pin x8, a na końcu opisu płyty głównej wskazuje, że wymaga złącze SYS FAN 4-pin x4. Prosimy o wykreślenie zapisu „złącze SYS FAN 4-pin x8”, ponieważ opisywana płyta główna posiada 4 złącza SYS FAN 4-pin, a nie jak błędnie wskazuje Zamawiający 8 szt. Proszę to zmienić, bowiem zostało to zweryfikowane.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „złącze SYS FAN 4-pin x8” z opisu płyty głównej. Zamawiający zmieni Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w Części 1.

Powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Ich nieuwzględnienie w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokona zmiany SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

ZMIANA SWZ

Działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmiany wprowadzone do treści SWZ, dokonane na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

I. W rozdziale III SWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Przed zmianą:

7. Szczegółowy opis i wymagania zamówienia zostały określone w **Załączniku nr 4 do SWZ**.

Po zmianie:

7. Szczegółowy opis i wymagania zamówienia zostały określone w **Załączniku nr 4 do SWZ po zmianie**.

II. W rozdziale V SWZ. Termin związania ofertą.

Przed zmianą:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:
15.02.2025r.

Po zmianie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:
19.02.2025r.

III. W rozdziale XII SWZ. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

Przed zmianą:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania – w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	18.11.2024 r.	do godz.	11.00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

Po zmianie:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania – w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	22.11.2024 r.	do godz.	11.00
---------	---------------	----------	-------

IV. W rozdziale XII SWZ. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

Przed zmianą:

1) Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	18.11.2024 r.	o godz.	11.15
--------	---------------	---------	-------

Po zmianie:

1) Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	22.11.2024 r.	o godz.	11.15
--------	---------------	---------	-------

V. W Załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Część 1 – Dostawa komputera wysokowydajnego do obliczeń dynamiki molekularnej

Komputer wysokowydajny do obliczeń dynamiki molekularnej	
Komputer	
Ilość : 2 sztuki	
Procesor	<ul style="list-style-type: none">▪ procesor minimum 32-rdzeniowy (64 wątkowy), zapewniający komputerom w testach Cinebench R23: minimum 1988 punktów dla jednego rdzenia oraz 65269 punktów dla wielu rdzeni; 97702 punktów w Passmark CPU Mark – na dzień 10.10.2024r.,▪ możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych,▪ min. 4.0 GHz,▪ pamięć podręczna L3: min. 128 MB,▪ chłodzenie procesora na poziomie NSPR 130,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ilość ciepłowodów min. 6, ▪ ilość wentylatorów min. 2, ▪ żywotność min. 300000 godzin.
Karta graficzna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyposażona w minimum 16 GB pamięci RAM GDDR6X, ▪ chłodzenie aktywne, ▪ typ złącza PCI Express 3.0 x16, ▪ jednostki TMU: min. 320, ▪ jednostki ROP: min. 112, ▪ procesory strumieniowe: min. 10240, ▪ szyna 256 bit, ▪ liczba wentylatorów min. 3, ▪ taktowanie rdzenia (bazowe): min. 2205 MHz, ▪ efektywne taktowanie pamięci min. 23000 MHz.
Pamięć RAM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ typ DDR5, ▪ 64 GB RAM (2 x 32 GB), ▪ Zakres częstotliwości: 5600 – 6000 MHz, ▪ Zakres opóźnienia: CL 32-36.
Dysk SSD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>ilość: 2 sztuki</u>, ▪ pojemność dysku przynajmniej 2 TB, ▪ format dysku M.2 2280, ▪ interfejs PCI-E x 4 Gen4 NVMe, ▪ szybkość odczytu nie mniej niż 7000 MB/s, ▪ szybkość zapisu nie mniej niż 7000 MB/s.
Płyta główna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ standard pamięci DDR5, ▪ chipset płyty głównej TRX50, ▪ częstotliwość pracy pamięci – umożliwiające pracę na 7800 MHz, ▪ pamięć zainstalowana do 1024 GB, ▪ quad channel, ▪ chipset dźwiękowy, ▪ zintegrowana karta sieciowa – 10/100/1000/2500, ▪ praca bezprzewodowa – Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), ▪ gniazda rozszerzeń – min. PCI Express x16 (2 szt.), PCI Express x4 (1 szt.), ▪ złącza napędów – M.2 slot x4, SATA 3x8, ▪ złącza dostępne min: <ul style="list-style-type: none"> - USB 2.0 x3,

	<ul style="list-style-type: none"> - USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1, - USB-C 3.2 Gen 2x2 x1, - złącze AIO_PUMP 4-pin x1, - złącze ATX 24-pin 12V x1, - złącze ATX 8-pin 12V x2, - złącze audio panelu przedniego (AAFP) x1, - złącze CPU FAN 4-pin x1, - złącze SYS FAN 4-pin x8, - złącze czujnika termicznego x1, - złącze panelu systemu x1, - złącze SYS FAN 4-pin x4.
Zasilacz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc min. 1000 W, ▪ w pełni modularne okablowanie, ▪ posiadający certyfikat min. Gold 80+ lub równoważnym tzn. osiągającym przy 50% obciążenia aż 90% sprawności, oraz 87% sprawności przy 20% i 100% obciążenia, ▪ ATX 3.0, ▪ zabezpieczenia: min. OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP.
Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obudowa posiadająca min. 2 zainstalowane wentylatory min. 120 mm, ▪ umożliwia montaż płyty w standardzie Extended ATX, ▪ min. USB – 1 szt., ▪ min. USB Typu C – 1 szt., ▪ wyjście słuchawkowe / głośnikowe – 1 szt., ▪ wejście mikrofonowe – 1 szt., ▪ system aranżowania kabli, ▪ otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor, ▪ filtry antykurzowe.
<p>Monitor</p> <p>Ilość : 2 sztuki</p>	
Monitor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przekątna ekranu min. 34", ▪ rozdzielczość 3440 x 1440, ▪ typ matrycy LED, VA, ▪ odświeżanie min. 120 Hz, ▪ format 21:9, ▪ czas reakcji <=1ms (MPRT), ▪ jasność min. 400 cd/m2, ▪ kąt widzenia min. 88°/88°(góra/dół, prawo/lewo),

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ złącza – min. display port x2, HDMI x2, ▪ złącza USB 3.2 Gen. w liczbie od 1 do 4 portów
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ minimum 36 miesięcy

Po zmianie:

Część 1 – Dostawa komputera wysokowydajnego do obliczeń dynamiki molekularnej

Komputer wysokowydajny do obliczeń dynamiki molekularnej	
Komputer	
Ilość : 2 sztuki	
Procesor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ procesor minimum 32-rdzeniowy (64 wątkowy), zapewniający komputerom w testach Cinebench R23: minimum 1988 punktów dla jednego rdzenia oraz 65269 punktów dla wielu rdzeni; 97702 punktów w Passmark CPU Mark – na dzień 10.10.2024r., ▪ możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, ▪ min. 4.0 GHz, ▪ pamięć podręczna L3: min. 128 MB, ▪ chłodzenie procesora na poziomie min. NSPR 130, ▪ ilość ciepłowodów min. 6, ▪ ilość wentylatorów min. 2, ▪ żywołność min. 150000 godzin.
Karta graficzna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyposażona w minimum 16 GB pamięci RAM GDDR6X, ▪ chłodzenie aktywne, ▪ typ złącza PCI Express 3.0 x16, ▪ jednostki TMU: min. 320, ▪ jednostki ROP: min. 112, ▪ procesory strumieniowe: min. 10240, ▪ szyna 256 bit, ▪ liczba wentylatorów min. 3, ▪ taktowanie rdzenia (bazowe): min. 2205 MHz, ▪ efektywne taktowanie pamięci min. 23000 MHz.
Pamięć RAM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ typ RDIMM DDR5, ▪ 64 GB RAM (2 x 32 GB lub 4 x 16 GB), ▪ Zakres częstotliwości: 5600 – 6000 MHz, ▪ Zakres opóźnienia: CL 32-48.


Dysk SSD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ilość: 2 sztuki, ▪ pojemność dysku przynajmniej 2 TB, ▪ format dysku M.2 2280, ▪ interfejs PCI-E x 4 Gen4 NVMe, ▪ szybkość odczytu nie mniej niż 7000 MB/s, ▪ szybkość zapisu nie mniej niż 7000 MB/s.
Płyta główna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ standard pamięci DDR5, ▪ chipset płyty głównej TRX50, ▪ częstotliwość pracy pamięci – umożliwiające pracę na 7800 MHz, ▪ pamięć zainstalowana do 1024 GB, ▪ quad channel, ▪ chipset dźwiękowy, ▪ zintegrowana karta sieciowa – 10/100/1000/2500, ▪ praca bezprzewodowa – Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), ▪ gniazda rozszerzeń – min. PCI Express x16 (2 szt.), PCI Express x4 (1 szt.), ▪ złącza napędów – M.2 slot x4, SATA 3x8, ▪ złącza dostępne min: <ul style="list-style-type: none"> - USB 2.0 x3, - USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1, - USB-C 3.2 Gen 2x2 x1, - złącze ATX 24-pin 12V x1, - złącze ATX 8-pin 12V x2, - złącze audio panelu przedniego (AAFP) x1, - złącze czujnika termicznego x 1, - złącze panelu systemu x1, - 1 x złącze wentylatora procesora, - 1 x CPU fan/water cooling pump header, - 4 x złącza system fan, - 4 x system fan/water cooling pump headers
Zasilacz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc min. 1000 W, ▪ w pełni modularne okablowanie, ▪ posiadający certyfikat min. Gold 80+ lub równoważnym tzn. osiągającym przy 50% obciążenia aż 90% sprawności, oraz 87% sprawności przy 20% i 100% obciążenia, ▪ ATX 3.0,

	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenia: min. OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP.
Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> obudowa posiadająca min. 2 zainstalowane wentylatory min. 120 mm, umożliwia montaż płyty w standardzie Extended ATX, min. USB – 1 szt., min. USB Typu C – 1 szt., wyjście słuchawkowe / głośnikowe – 1 szt., wejście mikrofonowe – 1 szt., system aranżowania kabli, otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor, filtry antykurzowe.
Monitor Ilość : 2 sztuki	
Monitor	<ul style="list-style-type: none"> przekątna ekranu min. 34", rozdzielczość 3440 x 1440, typ matrycy LED, VA, odświeżanie min. 120 Hz, format 21:9, czas reakcji <=1ms (MPRT), jasność min. 400 cd/m2, kąt widzenia min. 88°/88°(górną/dół, prawo/lewo), złącza – min. display port x2, HDMI x2, złącza USB 3.2 Gen. w liczbie od 1 do 4 portów
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> minimum 36 miesięcy

Zmianie ulega załącznik: **Załącznik nr 4 do SWZ** - Opis przedmiotu zamówienia (Część 1). Zmieniony załącznik (Załącznik nr 4 do SWZ po zmianie) zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dokonaną zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/S 221-690601 z dnia 13.11.2024r. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dziekan
Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański